

<<电子技术工艺基础>>

图书基本信息

书名：<<电子技术工艺基础>>

13位ISBN编号：9787302156758

10位ISBN编号：7302156751

出版时间：2007-8

出版时间：清华大学

作者：朱定华

页数：289

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子技术工艺基础>>

内容概要

《电子技术工艺基础》介绍了安全用电的基本常识、焊接技术的具体操作和表面贴装技术、常用元器件的测试、电子装配工艺的要求及调试、手工设计印制电路板、计算机辅助设计印制电路板、电路仿真、电子技术工艺文件等具体内容，具有一定的实用性。

《电子技术工艺基础》注重理论与实践相结合，书中用具体的实例和详细的说明，加深读者对该书内容的认识与掌握。

其内容通俗易懂，知识面宽，注重实用，语言精练，适用于灵活教学。

《电子技术工艺基础》可作为各高等学校理工科及相关专业学生电子工艺实习的教材，还可适用于不同教学条件和教学要求的职业教育和技术培训机构作为参考资料。

<<电子技术工艺基础>>

书籍目录

第1章 安全用电及急救措施1.1 安全用电1.1.1 触电的伤害和形式1.1.2 电子焊接安全操作1.1.3 防止触电及预防措施1.2 触电急救与防雷技术1.2.1 触电急救1.2.2 电气消防1.2.3 防雷技术思考与习题第2章 焊接技术2.1 焊接概念2.1.1 焊料2.1.2 助焊剂2.1.3 阻焊剂2.2 锡焊焊接的机理2.3 常用焊接工具2.3.1 电烙铁2.3.2 其他工具2.4 手工锡焊技术2.4.1 手工焊接的基本要领2.4.2 正确的焊接姿势2.4.3 手工焊接步骤2.4.4 手工焊接的工艺要求2.5 焊接质量及分析2.5.1 可靠的电气连接2.5.2 机械强度的可靠性2.5.3 外观要光洁整齐2.6 常见焊点缺陷及其原因2.7 拆焊技术2.7.1 吸锡专用工具2.7.2 拆焊材料2.7.3 拆焊要点2.7.4 拆焊后处理2.8 焊接技艺技能训练2.8.1 印制电路板上元器件的焊装2.8.2 导线在各种端头上的连接2.8.3 无锡焊接2.9 电子产品自动焊接技术2.9.1 浸焊2.9.2 波峰焊2.10 表面贴装技术2.10.1 表面贴装技术的特点2.10.2 表面贴装元器件的种类2.10.3 表面贴装印制电路板(SMB) 2.10.4 表面贴装手工焊接技术2.10.5 表面贴装波峰焊技术2.10.6 表面贴装再流焊技术思考与习题第3章 电子装配工艺3.1 电子产品结构工艺3.1.1 工艺特点3.1.2 工艺和结构设计3.2 整机装配3.2.1 装配工艺3.2.2 紧固元器件工艺3.3 导线连接工艺3.3.1 导线的选择3.3.2 导线加工工艺3.4 元器件选择3.4.1 元器件的检验3.4.2 元器件的筛选3.5 元器件成型和安装工艺3.5.1 元器件预成型工艺3.5.2 元器件安装工艺.....第4章 印制电路板设计第5章 电子线路CAD第6章 电子技术工艺文件第7章 电路仿真第8章 电子元器件附录

<<电子技术工艺基础>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>